

冷镶嵌耗材



冷镶粉



固化剂

型号	说明	包装
MLP-CM1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷镶王, 产品镶嵌速度快/透明度较好/低粘度/强度高 2. 适用于无须加热、无须加压、无须镶嵌机的金属加工行业 3. 固化时间: 25°C, 25分钟 4. 使用比例: 冷镶粉3:固化剂2 	冷镶粉1000克, 固化剂800ml, Ø30冷镶嵌模1个, 塑料杯20件, 搅拌棒40支, 勺1把
MLP-CM2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 环氧树脂王, 进口原液, 低粘度, 渗透性好, 完全透明 2. 适用于试样不能被加热或无镶嵌机, PCB、SMT等电子场所微切片样品的镶嵌 3. 固化时间: 25°C, 5~6小时 4. 使用比例: 树脂液2:固化剂1 	树脂液1000ml, 固化剂500ml, Ø30冷镶嵌模1个, 塑料杯20件, 搅拌棒40支
MLP-CM3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 快速环氧王, 产品快速固化, 完全透明 2. 适用于试样不能被加热或无镶嵌机, PCB、SMT等电子场所微切片样品的镶嵌 3. 固化时间: 25°C, 1小时 4. 使用比例: 树脂液2:固化剂1 	树脂液1000ml, 固化剂500ml, Ø30冷镶嵌模1个, 塑料杯20件, 搅拌棒40支
MLP-CM4	<ol style="list-style-type: none"> 1. 低粘度环氧王, 产品低粘度, 渗透性好, 完全透明 2. 适用于试样不能被加热或无镶嵌机, PCB、SMT等电子场所微切片样品的镶嵌 3. 固化时间: 25°C, 3~4小时 4. 使用比例: 树脂液2:固化剂1 	树脂液1000ml, 固化剂500ml, Ø30冷镶嵌模1个, 塑料杯20件, 搅拌棒40支
MLP-CM5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 低发热环氧王, 产品发热少, 收缩小, 完全透明 2. 适用于试样不能被加热或无镶嵌机, PCB、SMT等电子场所微切片样品的镶嵌 3. 固化时间: 25°C, 20~24小时 4. 使用比例: 树脂液3:固化剂1 	树脂液1000ml, 固化剂300ml, Ø30冷镶嵌模1个, 塑料杯20件, 搅拌棒40支
MLP-CM6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷镶王, 产品镶嵌速度快/瓷白色/低粘度/强度高 2. 适用于无须加热、无须加压、无须镶嵌机的金属加工行业 3. 固化时间: 25°C, 25分钟 4. 使用比例: 冷镶粉3:固化剂2 	冷镶粉1000克, 固化剂800ml, Ø30冷镶嵌模1个, 塑料杯20件, 搅拌棒40支, 勺1把